

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

建議分拆比亞迪半導體並於深交所上市之最新進展

謹此提述比亞迪股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月三十日及二零二一年六月十六日的公告及本公司日期為二零二一年五月三十一日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議分拆本公司的非全資子公司比亞迪半導體股份有限公司(前稱為比亞迪半導體有限公司)(「比亞迪半導體」)並於深交所創業板獨立上市。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，近日，比亞迪半導體提交了其股份於深交所創業板首次公開發售及上市的申請材料，並於二零二一年六月二十九日接獲深交所發出的《關於受理比亞迪半導體股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市申請文件的通知》(深證上審[2021]283號)。深交所依據相關規定對比亞迪半導體報送的首次公開發行股票並在創業板上市的申請報告及相關申請文件進行了核對，認為文件齊備，決定予以受理。

由於本公司於比亞迪半導體的股權預期於分拆完成後將會減少，故分拆將構成上市規則第十四章項下本公司之視作出售事項。目前預期分拆的最高適用百分比率均將低於5%。因此，分拆並不構成上市規則第十四章項下本公司的須予公佈交易，且毋須遵守上市規則第十四章項下的公告、申報及股東批准規定。

由於分拆須遵守上市規則第15項應用指引，本公司已就分拆向香港聯交所提交申請。於本公告日期，香港聯交所正審閱有關申請，而有關分拆的批准尚未授出。

本公司將遵守上市規則項下的適用規定，並於適當時候作進一步公告。

股東及有意投資者務請注意，於創業板分拆須視乎（其中包括）當前市況及待相關部門（包括中國證監會、深交所及香港聯交所）批准後，方可作實。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國深圳，二零二一年六月三十日

於本公告刊發日期，本公司的董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。